

安徽耐科装备科技股份有限公司

证券简称：耐科装备 证券代码：688419 编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	东北证券 李玖 东北证券 孙科 中欧基金 刘金辉
时间	2026年06月03日
地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事长：黄明玖 董事会秘书：黄戎、董事会办公室职员：刘胡洁、刘爽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场参观</p> <p>参观了半导体封装装备研发、制造和装配车间，观看了采用压塑成型工艺的基板类封装装备成型样机和板级/晶圆级封装装备试制样机。</p> <p>二、会议交流（会议交流内容如下）</p> <p>1、2026年新签订合同情况？</p> <p>目前公司在手订单充足，生产饱满。截至5月10日，2026年新签订合同总额2.6亿元。</p> <p>3、半导体封装装备交货周期和产能情况？</p> <p>半导体封装装备为定制化产品，根据客户需求生产，因产品结构、技术参数不同，制造加工交货周期也不同，没有严格的产能指标。目前募投项目半导体封装装备新建项目已投入使用，正处于制造能力提升阶段。</p>

	<p>4、压塑成型封装设备研发情况？</p> <p>公司目前涉及压塑工艺封装装备研发项目有多项，包括 100mm×300mm 基板类封装装备、320mm×320mm 大尺寸板级封装装备以及晶圆级封装装备等，其中 100mm×300mm 基板类封装装备样机已成型，近期将发往客户端进行试用。</p> <p>5、半导体封装装备主要客户有哪些？</p> <p>目前公司半导体封装装备客户共有 130 余家，其中包括通富微电、长电科技、华天科技等国内头部封装企业，经过前期海外市场开拓，目前已成功与东南亚安世、英飞凌等多家国际半导体知名企业建立合作。</p> <p>6、如何看待订单转化进度偏缓、财报业绩不及预期的现状？</p> <p>公司产品为定制化产品，根据客户需求生产，因产品结构、技术参数不同，制造加工和验收周期也不同。其中半导体封装装备以取得客户验收报告时间确认收入；挤出成型装备主要出口国外，按照报关单和提单孰晚时间确认收入。一季度业绩不及预期主要因短期客户结构和产品订单结构影响所致。</p> <p>8、贵司的基板级粉末封装预计定价在哪个区间？</p> <p>基板级粉末封装正处于成型样机测试完善阶段，暂无定价。</p> <p>9、公司订单有季节性吗？</p> <p>公司产品为定制化产品，无季节性。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 06 月 03 日